

四川省“成果找市场”揭榜挂帅 2025 年第二批榜单

榜单 21：半导体制造业国产智能 CIM 系统应用及产业化

技术成果简介	描述成果的创新性、先进性及关键技术指标。（300 字以内） 该技术成果研发新一代国产智能 CIM 系统，满足 3/4/6/8/12 吋晶圆厂所需功能，支持高效稳定的生产管理。由 MES（生产执行系统）、EAP（设备自动化）、RMS（程序管理系统）、SPC（统计过程控制）、YMS（良率分析控制系统）、APC（先进过程控制）、FDC（故障侦测及分类）、RTD（FAB 实时调度排产系统）等数十种制造相关工业软件协同合作，全面覆盖半导体生产线控制需求。智能 CIM 系统利用大数据平台及基于工作流的流数据分析引擎、AI 算法，增强传统 CIM 系统的数据整理分析及决策能力，通过产业化应用拓展，为半导体制造业提供整体解决方案，构建智能化半导体制造加工控制国产化软件平台。
拟转化（研究）内容	描述相关成果转化以及技术更新迭代的内容，如标志性产品研发、技术应用场景、应用示范及规模等。（300 字以内） 本技术成果预计对于国内客户来说，采购成本可下降 30%-40%，同时赛美特能提供模块定制化服务及更直接的全方位本地化服务。技术成果达到国内领先水平，能够打破国外厂商垄断，解决国内半导体工业软件卡脖子困境，打破中国 12 吋全自动半导体制造业 CIM 软件系统被欧美企业垄断的技术壁垒。
考核指标	提出具体考核指标，如：技术参数指标、人才培养指标、专利、论文等科研成果情况、应用示范目标、产业化目标（新增利润或销售收入）等。

	技术指标： (1)支持复杂工艺模型、自动加工控制、加工质量控制、工艺监控。 (2)支持生产调度自动化、生产过程监控、基本工艺调优、良率分析、光刻板管理、Ocap 流程化。 (3)高级集成生产控制：暖机控制、预测模型调优、Wafer 级别工艺调优、10Hz 级别生产监控、Dual Reticle、N2 Purge、NPW 管理、RunCard 管理。 性能指标： (1)全模块实施达到 Auto3 水平。 (2)支持以满足 25000 片/月产能的性能要求。 (3)所有模块不出现系统响应迟钝，包括但不限于基本查询延时不超过 2 秒、复杂多表查询不超过 15 秒。 其他指标： (1)申请国家发明专利 3 项。
拟合作方式及拟合作金额	其他 4000 万元（人民币）
知识产权归属	明确发榜方和揭榜方在合作过程中各自提供的技术、资料、数据等，以及共同研发和转化过程形成的技术成果和知识产权归属 (1) 专利申请权：本研发项目专利申请权归属赛美特所有。 (2) 项目中所有涉及实施过程中的所有开发工具及中间件等授权，实施验收通过后都属于揭榜方所有。

对揭榜方的要求	提出时间节点（几个阶段）、揭榜方资产、人才团队、科研条件，落地转化区域等要求。 一、本项目预计分两个阶段实施： （1）2025 年 1 月至 2025 年 6 月，完成核心功能的研发； （2）2025 年 7 月至 2025 年 12 月，分阶段按实际情况实施相应的模块，完成技术转化，完成项目验收； 二、揭榜方应为国内领先的高效、智能、集成新型半导体企业，以车规级半导体为核心业务，产品后续可以覆盖新能源汽车、工业、家电、新能源、消费电子等应用领域。
联系人及联系方式	王老师 18121106313